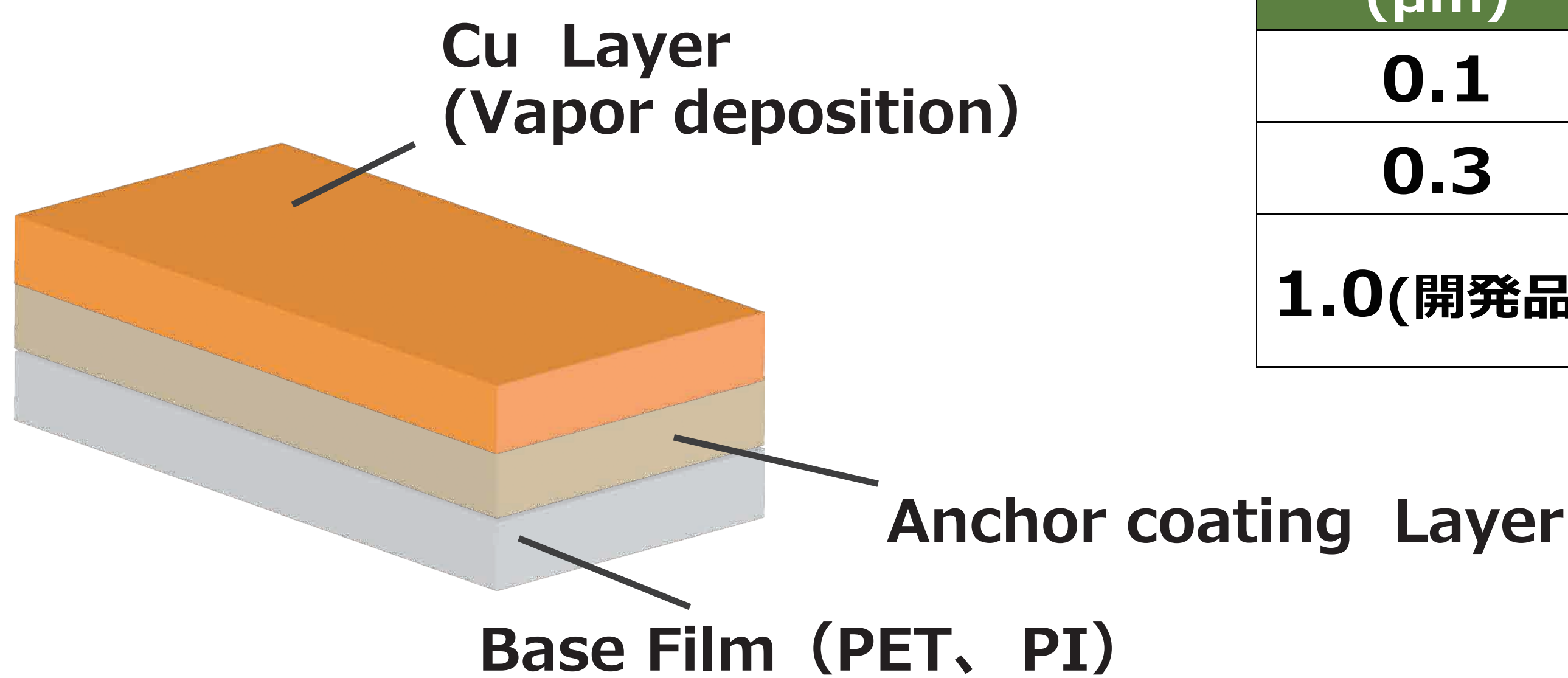


導電性フィルム (Cu 蒸着)

conductive film (Copper)

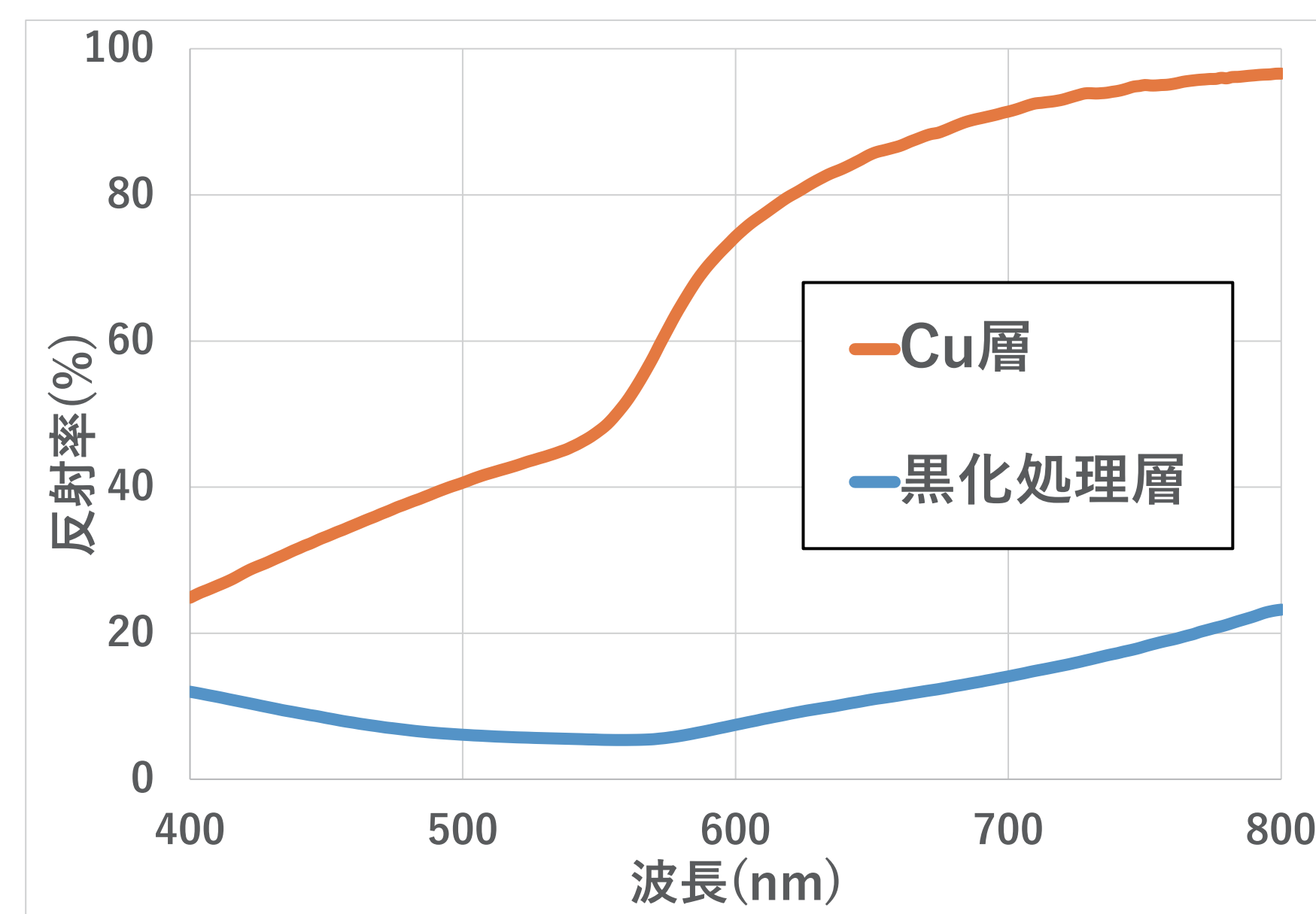
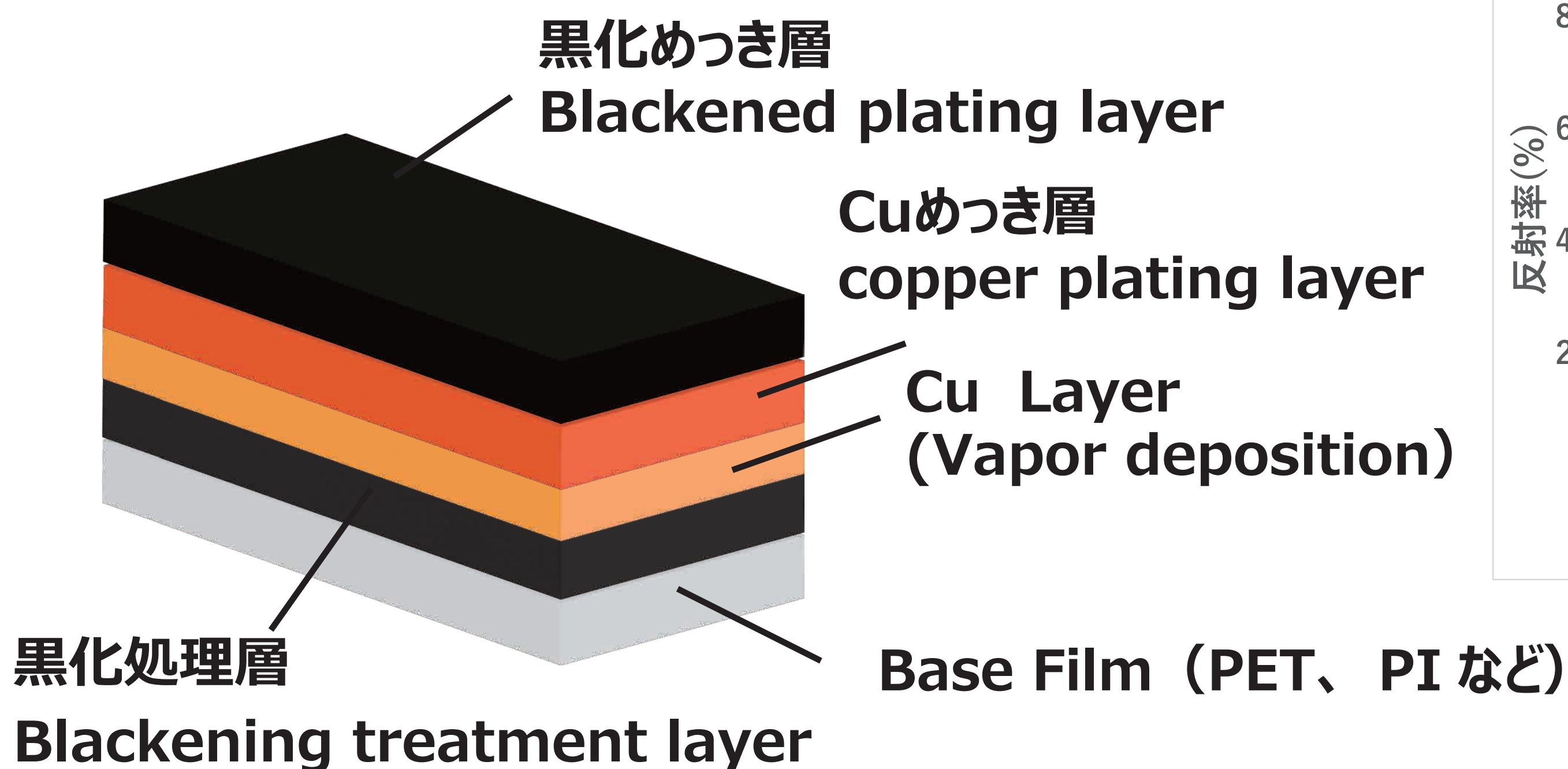
- ▶ **様々な基材 (PET、PI など) に導電性付与**
We can impart conductivity to various substrates (PET, PI, etc.)
- ▶ **銅箔代替、めっきシード層としても使用可能**
It can also be used as a copper foil substitute and plating seed layer
- ▶ **基材への黒化処理により 導電性+低反射化 を実現**
It achieves conductivity and low reflection by blackening the base material.

◇ Cu 蒸着フィルム



Cu膜厚 (μm)	表面抵抗率 (Ω/□)	クロスカット 密着
0.1	2.0×10^{-1}	100/100
0.3	8.0×10^{-2}	100/100
1.0(開発品)	1.7×10^{-2}	100/100

◇ Cu 蒸着フィルム (黒化処理)



上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values.